

# Produktdatenblatt

DIN 41612 VME 64x Federleiste,  
Art. Nr. 306-65069-14

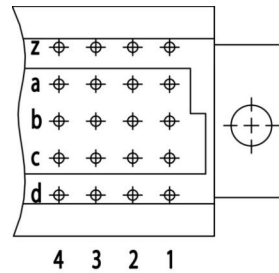
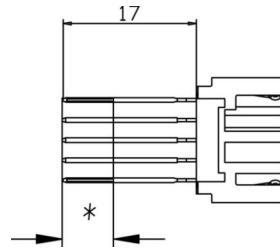
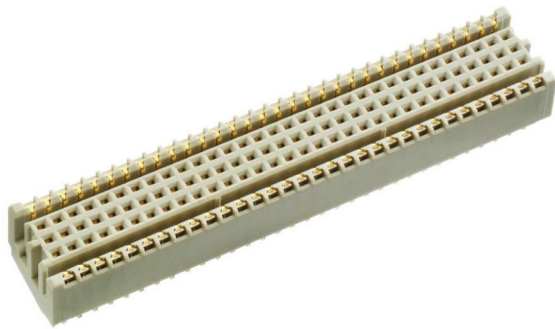


Abbildung ähnlich



Rechtwinklig



Einpresstechnik



Rugged

- Anschlusslänge 17 mm
- mit Steckzone in Gütestufe 1
- Polzahl 160
- Einpresstechnik
- Gütestufe 1
- DIN Flansch



» zum Produkt auf [www.ept.de](http://www.ept.de)



» zur Produktgruppe DIN 41612

# Produktdatenblatt

DIN 41612 VME 64x Federleiste,  
Art. Nr. 306-65069-14



## Technische Daten

### Grundlagen

Spezifikation	IEC 61076-4-113
Gütestufe	1
Anzahl Kontakte	160
Anschluss technik	Einpresstechnik
Anschlusslänge	17 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

### Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
CTI Wert <i>IEC 60112</i>	200
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

### Mechanisch

Rastermaß	2.54 mm
Steckkraft	160 N
Ziehkraft pro Kontakt	> 0.15 N
Lebensdauer	500 Steckzyklen

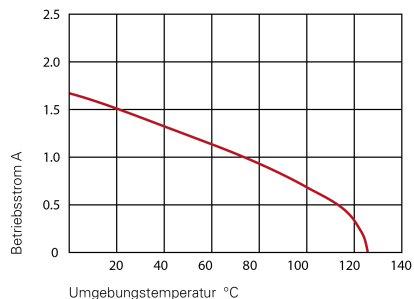
### Elektrisch

Betriebsstrom	1.5 A
Durchgangswiderstand	<20 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	abc ≥ 1.2 mm, zd ≥ 1.0 mm
Isolationswiderstand	10 <sup>4</sup> MΩ
Prüfspannung	1000 V

### Zulassungen / Konformität

UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

### Derating Diagramm



#### Bauform B, O, C, R

20 °C	1.5 A
70 °C	1.1 A
100 °C	0.7 A

### Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.0 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
<b>C Grundbohrung</b>	1.15 ±0.025 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.0 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
<b>C Grundbohrung</b>	1.15 ±0.025 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.0 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
<b>C Grundbohrung</b>	1.15 ±0.025 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	HAL Sn Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.0 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
<b>C Grundbohrung</b>	1.15 ±0.025 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	HAL Sn, 5 - 15 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

# Produktdatenblatt

DIN 41612 VME 64x Federleiste,  
Art. Nr. 306-65069-14

---



## Zubehör

» DIN 41612 Shroud VME  
Artikelnummer 315-15401

» DIN 41612 Shroud VME  
Artikelnummer 315-15402

## Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

» [PDF](#)